

强于大市

电子行业周报

微软发布企业级应用，元宇宙再升温

本周(11/1-11/5) SW 电子指数上涨 4.37%，沪深 300 指数下跌 1.35%，电子指数跑赢沪深 300 指数 5.72 个百分点，在一级行业中排 2/28。SW 电子各子行业涨跌幅：印制电路板(12.47%)、光学元件(8.61%)、分立器件(7.69%)、被动元件(6.95%)、集成电路(5.05%)、电子零部件制造(4.81%)、LED(4.09%)、电子系统组装(3.94%)、显示器件Ⅲ(3.25%)、半导体材料(2.77%)、其他电子Ⅲ(-4.22%)。截至本周收盘，电子行业市盈率 PE-TTM 为 36.16 倍。

支撑评级的要点

- **行业动态：1、Q3 全球半导体硅晶圆出货量创新高。**国际半导体产业协会报告显示，2021 年第三季度，全球半导体硅晶圆出货量季增 3.3%，达 36.49 亿平方英寸，续创历史新高，所有尺寸的硅晶圆出货量都有所增加。在市场终端应用强劲拉货下，硅晶圆供应持续紧张，环球晶、日本信越、日本胜高等硅晶圆供应商近期均预期产品供不应求情况将延续至 2023 年。**2、湾区半导体产业集团成立。**11 月 2 日，广州湾区半导体产业集团有限公司举行成立仪式。湾区半导体产业集团于 2021 年 10 月 29 日正式注册成立，注册资本 160 亿元，采用政府引导、多元化混合所有制、专业团队运营、高度市场化运作的运行模式，致力打造“产业投资+产业整合+运营管理+生态构建”的开放式平台，通过资源整合，打通从芯片设计服务、制造、封测、模组到应用端的全产业链，提供系统级解决方案，发挥产业生态聚合效应。**3、吉利汽车 7nm 智能座舱芯片明年量产。**吉利汽车宣布，由“芯擎”科技自研的智能座舱芯片 SE1000 采用车规级 7 纳米工艺，多核异构，将于明年量产。2024 到 2025 年，吉利汽车会陆续推出 5 纳米的车载一体化超算平台芯片，以及高算力自动驾驶芯片，算力达到 256TOPS。到 2025 年，实现 L4 级自动驾驶的商业化，完全掌握 L5 级自动驾驶。**4、紫光集团重整招募战略投资者最新进展。**由智路资本和建广资产组成的联合体、阿里巴巴和浙江省国资组成的联合体入围下一轮竞标。**5、微软的元宇宙从企业级做起，将推 Mesh for Microsoft Teams。**11 月 2 日，微软在 Ignite 大会上宣布，计划将旗下聊天和会议应用 Microsoft Teams 打造成元宇宙，把混合现实会议平台 Microsoft Mesh 融入 Microsoft Teams 中。此外，Xbox 游戏平台将来也要加入元宇宙。**6、东微半导科创板 IPO 过会。**

建议关注

- IC 设计：韦尔股份、圣邦股份、北京君正、卓胜微、芯朋微、艾为电子、恒玄科技、兆易创新等
- 功率半导体：华润微、士兰微、捷捷微电、新洁能等
- IC 制造：中芯国际、华虹半导体（港股）
- IC 封测：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等
- 消费电子：立讯精密、歌尔股份、环旭电子、欧菲光、水晶光电等

风险提示

- 海外疫情控制不及预期；半导体景气不及预期；终端需求不及预期。

相关研究报告

- 《电子行业周报：Facebook 改名 Meta 专注元宇宙，多家半导体公司 IPO 过会》20211031
- 《电子行业周报：北美半导体设备出货额继续增长，手机出货量承压》20211024
- 《电子行业周报：需求与产能共振，半导体产业持续增长可期》20211017
- 《电子行业周报：三季报拉开序幕，晶圆厂格芯赴美上市》20211008
- 《电子行业周报：全球半导体市场高增，智能终端迎密集发布期》20210927
- 《电子行业 2021 年中报综述：行业高景气持续，H1 业绩高增长》20210913
- 《电子行业 2021 年度策略：掘金高景气板块，把握涨价行情》20201127

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

电子

证券分析师：王达婷

(8621)20328284

dating.wang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

目录

本周行业动态	4
1 半导体行业动态	4
2 智能终端动态	4
3 IPO 动态	5
行业数据跟踪	6
1 半导体景气数据跟踪	6
2 智能终端数据跟踪	7
附：本周行情回顾	9

图表目录

图表 1.	2021Q3 欧洲市场各智能手机品牌市占率	5
图表 2.	北美半导体设备制造 BB 值	6
图表 3.	全球半导体月销售额	6
图表 4.	DRAM 现货均价走势 (美元)	6
图表 5.	NAND 现货均价走势 (美元)	6
图表 6.	CIS 价格月度走势 (美元)	6
图表 7.	液晶面板价格走势 (美元/片)	6
图表 8.	国内智能手机月度出货量及同比	7
图表 9.	智能手机新机机型数及同比	7
图表 10.	全球智能手机季度出货量及同比	7
图表 11.	国内新能源车月产量及同比	7
图表 12.	iPhone 季度出货量	7
图表 13.	2Q21 全球 TWS 出货量	8
图表 14.	本周申万一级行业涨跌幅	9
图表 15.	本周电子各子行业涨跌幅	9
图表 16.	本周 SW 电子涨跌幅前 10 标的	9
图表 17.	SW 电子、半导体指数年初至今累计涨跌幅	10
图表 18.	2010 年至今申万电子板块 PE	10
图表 19.	费城半导体指数年初至今累计涨跌幅	10
图表 20.	台湾电子、半导体指数年初至今累计涨跌幅	10

本周行业动态

1 半导体行业动态

【Q3 全球半导体硅晶圆出货量创新高】

国际半导体产业协会报告显示，2021 年第三季度，全球半导体硅晶圆出货量季增 3.3%，达 36.49 亿平方英寸，续创历史新高，所有尺寸的硅晶圆出货量都有所增加。SEMI 预计硅晶圆需求仍将保持高位，未来几年内将新增许多晶圆厂。在市场终端应用强劲拉货下，硅晶圆供应持续紧绷，环球晶、日本信越、日本胜高等硅晶圆供应商近期均预期产品供不应求情况将延续至 2023 年。其中，胜高宣布将斥资 2287 亿日元在日本盖新厂，进行扩产。（SEMI）

【湾区半导体产业集团成立】

11 月 2 日，广州湾区半导体产业集团有限公司（以下简称“湾区半导体产业集团”）举行成立仪式。湾区半导体产业集团于 2021 年 10 月 29 日正式注册成立，注册资本 160 亿元，其中芯飞埔华认缴出资 55 亿元，持股 34.375%；科学城认缴出资 50 亿元，持股 31.25%，珠海懿源和广东省半导体及集成电路产业基金各认缴出资 20 亿元，分别持股 12.5%，芯耀熔华认缴出资 10 亿元，持股 6.25%，井冈山芯鼎认缴出资 5 亿元，持股 3.125%。

湾区半导体产业集团采用政府引导、多元化混合所有制、专业团队运营、高度市场化运作的运行模式，致力打造“产业投资+产业整合+运营管理+生态构建”的开放式平台，通过资源整合，打通从芯片设计服务、制造、封测、模组到应用端的全产业链，提供系统级解决方案，发挥产业生态聚合效应。（集邦咨询）

【吉利汽车 7nm 智能座舱芯片明年量产】

近日，吉利汽车在杭州湾研究总院正式发布了“智能吉利 2025 战略”，以及推动这一战略的“九大龙湾行动”。吉利汽车宣布，由“芯擎”科技自研的智能座舱芯片 SE1000 采用车规级 7 纳米工艺，多核异构，是中国第一颗 7 纳米制程的车规级 SOC 芯片，完成车规级认证后，将于明年量产。2024 到 2025 年，吉利汽车会陆续推出 5 纳米的车载一体化超算平台芯片，以及高算力自动驾驶芯片，算力达到 256TOPS。到 2025 年，实现 L4 级自动驾驶的商业化，完全掌握 L5 级自动驾驶。（吉利汽车官网）

【紫光集团重整新进展】

近日，紫光集团重整招募战略投资者一事有最新进展，由智路资本和建广资产组成的联合体、阿里巴巴和浙江省国资组成的联合体入围下一轮竞标。（集微网）

2 智能终端动态

【将推 Mesh for Microsoft Teams，微软的元宇宙从企业级做起】

11 月 2 日，微软在 Ignite 大会上宣布，计划将旗下聊天和会议应用 Microsoft Teams 打造成元宇宙，把混合现实会议平台 Microsoft Mesh 融入 Microsoft Teams 中。此外，Xbox 游戏平台将来也要加入元宇宙。微软的元宇宙从企业级做起。微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，微软打算通过一系列整合虚拟环境的新应用程序，让用户在相互连接的虚拟世界中生活、工作和娱乐，将数字世界和物理世界结合在一起。他分享了关于混合现实会议平台 Microsoft Mesh 的应用场景，允许不同位置的人们通过生产力工具 Teams 加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。Microsoft Mesh 目前正在测试中，将于 2022 年上半年推出。萨提亚·纳德拉还表示，虽然微软的元宇宙最初专注于企业级应用，但预计 Xbox 游戏平台将来也将参与其中。（中国电子报）

【Q3 欧洲智能手机市场】

Counterpoint 发布 2021 年第三季度欧洲智能手机销量数据。报告显示，第三季度欧洲智能手机销量同比下滑 1%，环比下滑 4%。其中，三星排名依旧领先，份额达 30.4%，但同比下降 16%；小米手机的销量排名第二，市场份额 23.6%，同比增长 51%；苹果排名第三，份额为 22.1%。国产手机品牌 OPPO、realme、vivo 则位列 4-6 名，均有不同程度的增长。小米 9 月份在欧洲市场销量下滑的原因是芯片短缺。（Counterpoint）

图表 1. 2021Q3 欧洲市场各智能手机品牌市占率

排名	公司	3Q21 市场份额(%)	3Q20 市场份额(%)	同比增长(%)	环比增长(%)
1	三星	30.4	35.8	(16)	(6)
2	小米	23.6	15.5	51	(6)
3	Apple	22.1	17.6	24	5
4	OPPO	10.1	4.7	112	2
5	Realme	2.4	0.9	160	12
6	vivo	1.8	0.5	238	22

资料来源：Counterpoint，中银证券

3 IPO 动态

【东微半导体】 苏州东微半导体股份有限公司科创板 IPO 成功过会。东微半导体是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业，专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域，主要产品包括 GreenMOS 系列高压超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET。公司的产品广泛应用于以新能源汽车直流充电桩、5G 基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工业照明电源为代表的工业级应用领域，以及以 PC 电源、适配器、TV 电源板、手机快速充电器为代表的消费电子应用领域。同时，公司不断进行技术创新，进一步开发了超级硅 MOSFET、TGBT 等新产品。公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力，集中优势资源聚焦新型功率器件的开发，是国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一，并在应用于工业级领域的高压超级结和中低压功率器件产品领域实现国产化替代。

【汇成股份】 合肥新汇成微电子股份有限公司科创板上市申请获受理。公司是集成电路高端先进封装测试服务商，主营业务以前段金凸块制造为核心，综合晶圆测试(CP)及后段玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)环节。目前，公司的封装测试服务聚焦于显示驱动芯片领域，主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

行业数据跟踪

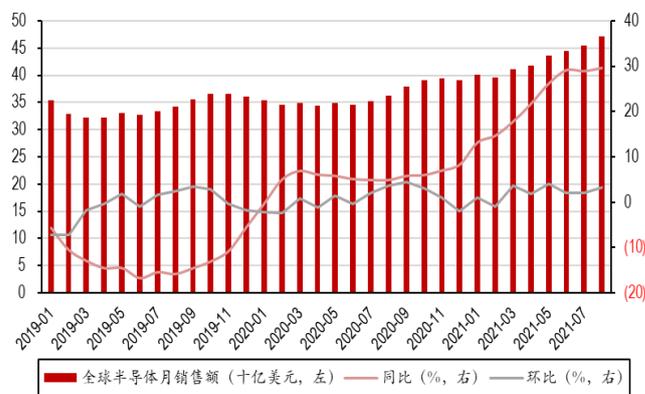
1 半导体景气数据跟踪

图表 2. 北美半导体设备制造 BB 值



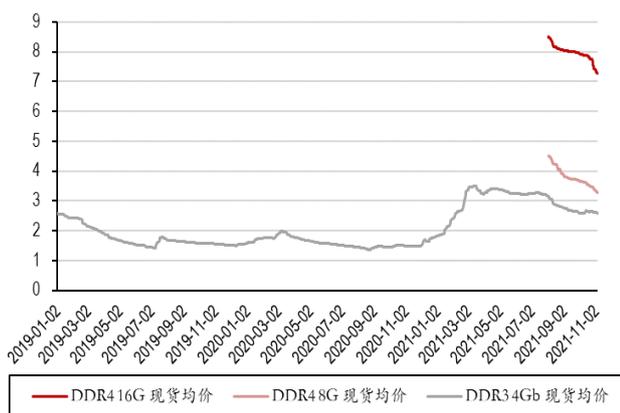
资料来源: 万得, 中银证券

图表 3. 全球半导体月销售额



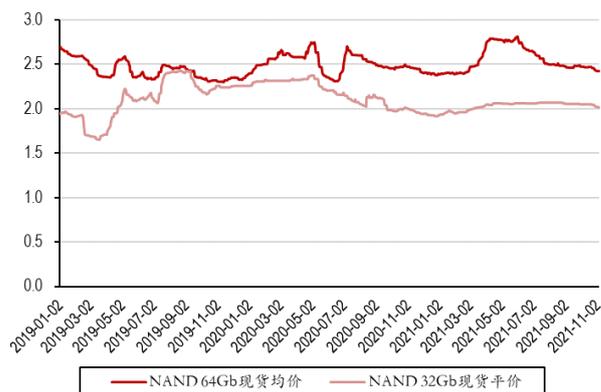
资料来源: 万得, 中银证券

图表 4. DRAM 现货均价走势 (美元)



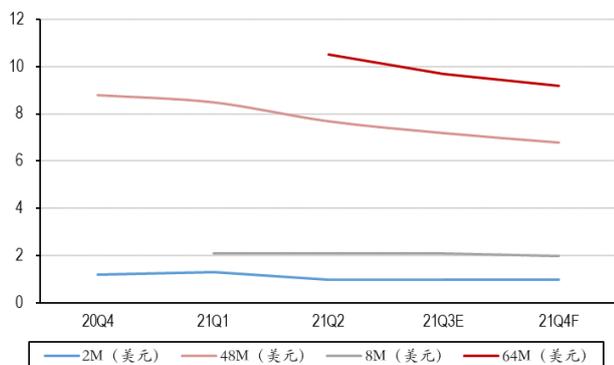
资料来源: 万得, 中银证券

图表 5. NAND 现货均价走势 (美元)



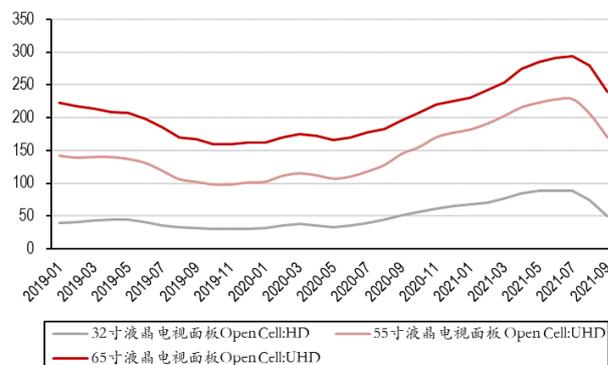
资料来源: 万得, 中银证券

图表 6. CIS 价格月度走势 (美元)



资料来源: 万得, 中银证券

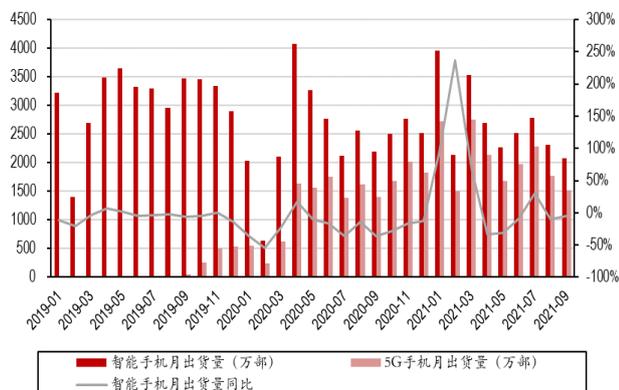
图表 7. 液晶面板价格走势 (美元/片)



资料来源: 万得, 中银证券

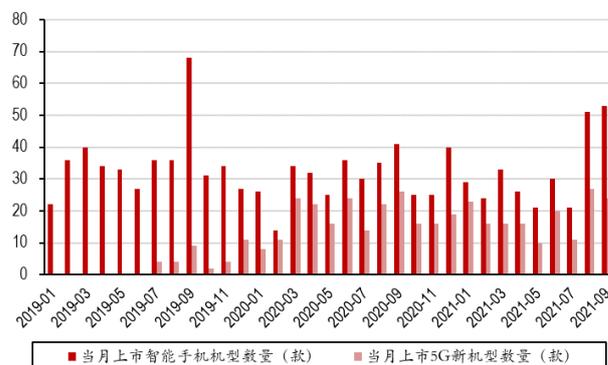
2 智能终端数据跟踪

图表 8. 国内智能手机月度出货量及同比



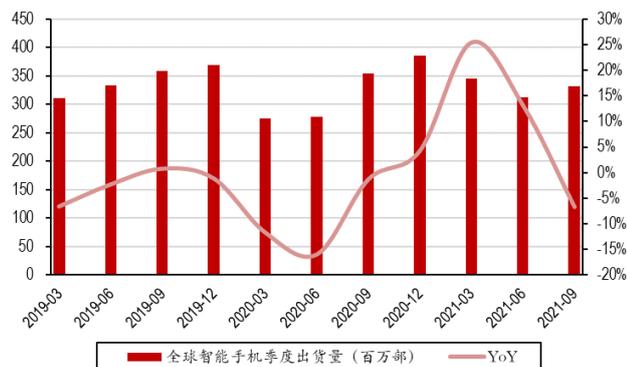
资料来源：工信部，中银证券

图表 9. 智能手机新机机型数及同比



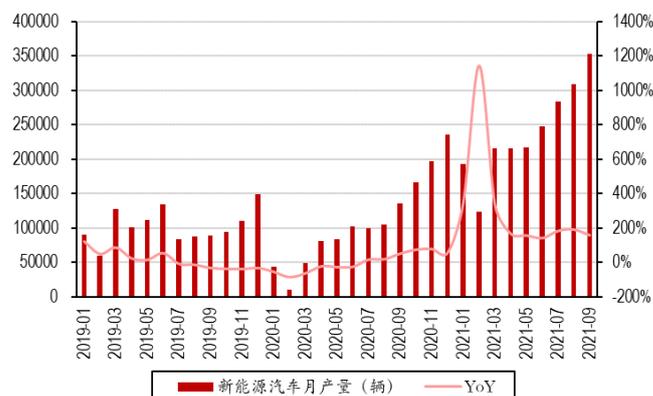
资料来源：工信部，中银证券

图表 10. 全球智能手机季度出货量及同比



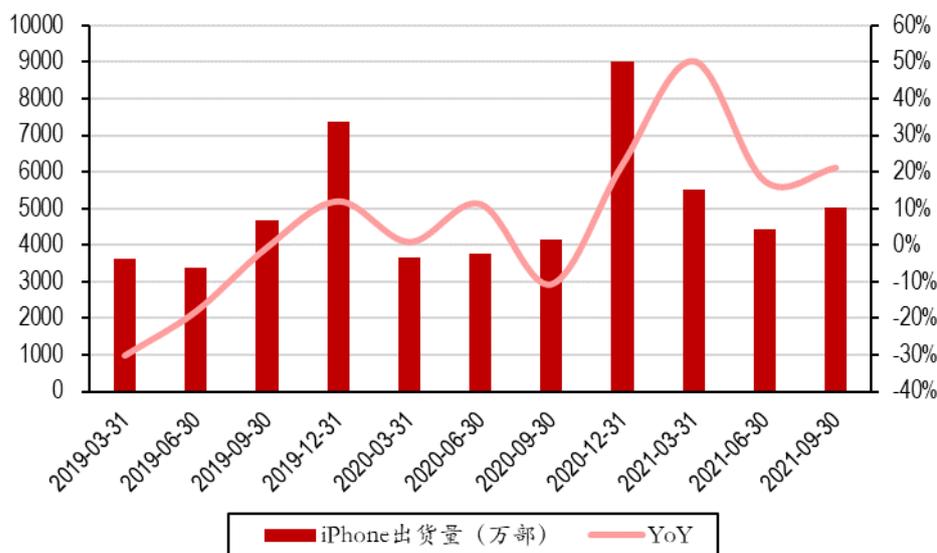
资料来源：IDC，中银证券

图表 11. 国内新能源车月产量及同比



资料来源：中汽协，中银证券

图表 12. iPhone 季度出货量



资料来源：IDC，中银证券

图表 13. 2Q21 全球 TWS 出货量

	2Q21 出货量 (百万部)	2Q21 市占率 (%)	2Q20 出货量 (百万部)	2Q20 市占率 (%)	YoY(%)
Apple (incl. Beats)	15.5	26.5	20.8	38.00	(25.8)
Xiaomi	5.3	9.1	5.0	9.20	5.7
Samsung (incl. Harman subsidiaries)	5.2	8.8	3.7	6.70	40.5
Skullcandy	4.1	7.0	1.1	1.90	285.4
QCY	2.5	4.2	2.9	5.40	(15.8)
Others	25.9	44.3	21.3	38.80	21.3
Total	58.3	100.0	54.9	100.00	6.4

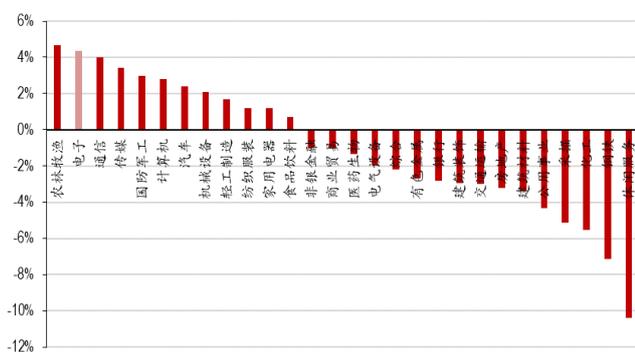
资料来源：工信部，中银证券

附：本周行情回顾

本周 (11/1-11/5) SW 电子行业指数上涨 4.37%，沪深 300 指数下跌 1.35%，电子行业指数跑赢沪深 300 指数 5.72 个百分点，在所有一级行业中排 2/28。SW 电子各子行业涨跌幅：印制电路板 (12.47%)、光学元件 (8.61%)、分立器件 (7.69%)、被动元件 (6.95%)、集成电路 (5.05%)、电子零部件制造 (4.81%)、LED (4.09%)、电子系统组装 (3.94%)、显示器件Ⅲ (3.25%)、半导体材料 (2.77%)、其他电子Ⅲ (-4.22%)。

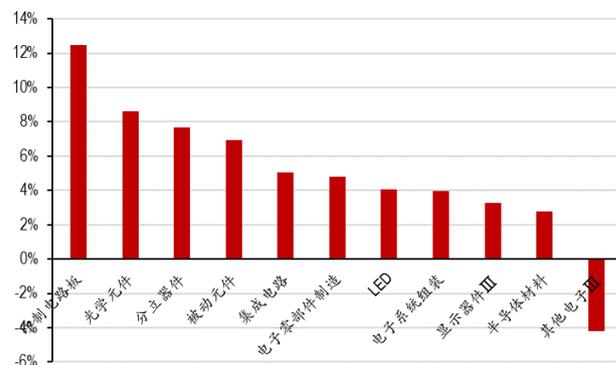
截至本周收盘，电子行业市盈率 PE-TTM 为 36.16 倍。

图表 14. 本周申万一级行业涨跌幅



资料来源：万得，中银证券

图表 15. 本周电子各子行业涨跌幅



资料来源：万得，中银证券

图表 16. 本周 SW 电子涨跌幅前 10 标的

本周涨幅前十位			本周跌幅前十位		
证券代码	公司名称	涨幅 (%)	证券代码	公司名称	涨幅 (%)
003043.SZ	华亚智能	50.58	002289.SZ	宇顺电子	(22.87)
003019.SZ	宸展光电	28.84	300390.SZ	天华超净	(16.73)
300812.SZ	易天股份	27.61	600751.SH	海航科技	(10.31)
002916.SZ	深南电路	27.04	002288.SZ	超华科技	(8.50)
603920.SH	世运电路	25.30	688036.SH	传音控股	(5.90)
600071.SH	凤凰光学	25.21	002141.SZ	贤丰控股	(5.36)
002937.SZ	兴瑞科技	25.20	300301.SZ	长方集团	(4.16)
300814.SZ	中富电路	25.15	000727.SZ	冠捷科技	(3.89)
300219.SZ	鸿利智汇	24.84	603068.SH	博通集成	(3.37)
002765.SZ	蓝黛科技	24.66	300613.SZ	富瀚微	(3.30)

资料来源：万得，中银证券

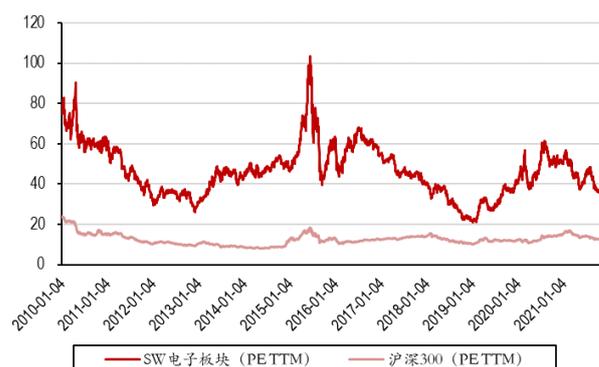
SW 电子指数年初至今累计上涨 10.34%，跑赢沪深 300 指数 17.41 个百分点；SW 半导体指数年初至今累计上涨 33.50%，跑赢沪深 300 指数 40.58 个百分点。

图表 17. SW 电子、半导体指数年初至今累计涨跌幅



资料来源：万得，中银证券

图表 18. 2010 年至今申万电子板块 PE



资料来源：万得，中银证券

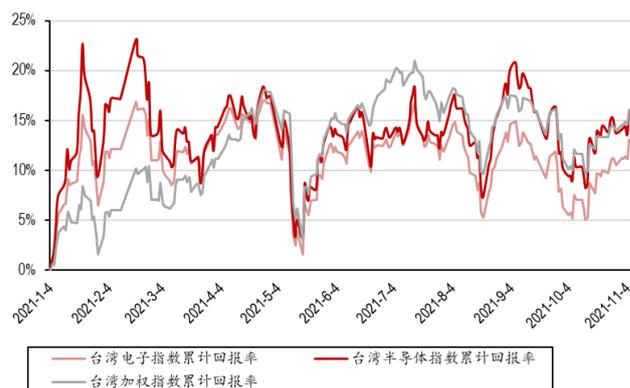
费城半导体指数年初至今累计上涨 34.38%，跑赢道琼斯指数 9.96 个百分点。台湾电子指数年初至今累计上涨 14.93%，跑输台湾加权指数 248 个百分点；台湾半导体指数年初至今累计上涨 17.63%，跑赢台湾加权指数 0.22 个百分点。

图表 19. 费城半导体指数年初至今累计涨跌幅



资料来源：万得，中银证券

图表 20. 台湾电子、半导体指数年初至今累计涨跌幅



资料来源：万得，中银证券

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中 性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中 性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371